

LOCTITE® 3619 30ML

Non-Conductive Adhesive

IDH1099559

LOCTITE 3619 30ML

- Epoksi
- Matala kovettumislämpötila
- Pintaliitoskomponenttien kiinnittämiseen piirilevyihin ennen juotosprosessia



TUOTEKUVAUS

LOCTITE® 3619 on tarkoitettu pintaliitoskomponenttien kiinnittämiseen piirilevyihin ennen juotosprosessia. Erityisen sopiva silloin, kun vaaditaan alhaisia kovettumislämpötiloja lämpöherkkien komponenttien kanssa ja prosesseissa, joissa vaaditaan lyhyitä kovettumisaikoja.

